

中微半导体（深圳）股份有限公司

2024 年度提质增效重回报行动评估报告

暨 2025 年度行动方案

为持续落实科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行以“投资者为本”的发展理念，中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“中微半导”或“公司”）于 2025 年 4 月 9 日经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过 2024 年度提质增效重回报行动评估报告暨 2025 年行动方案。

一、聚焦 MCU 研发，巩固公司主业竞争力

2024 年，在 MCU 市场行业持续内卷的形势下，公司聚焦 MCU 搞研发，全年投入研发经费 1.27 亿，持续推出具有竞争力的新品，丰富了公司产品阵列，完成了 8 位级产品系列化，32 位机低成本高性能产品完成投片，产品应用领域有效拓展，公司各类芯片出货量持续增加，全年出货量超过 24 亿颗，营业收入超过 9.1 亿元，出货量和营收同比增长约 30%，毛利率回升超过 10 个百分点，全年综合毛利率约 28%，公司实现净利润约 1.3 亿元。

2025 年，公司将持续聚焦 MCU 加大产品研发力度，深化专用 MCU 向通用 MCU 转型的产品策略，对于 8 位 MCU，通过技术改进和平台优化，提供更多性价比优良的产品，巩固已有的市场领导地位；对于 32 位 MCU，完成产品系列化布局；提高产品性能、品质，将产品应用从消费电子领域快速向工业控制、汽车电子等高附加值产品领域推进，扩大在工业控制、汽车电子领域的收入占比；进一步提高公司产品出货量和营业收入的增长速率。

二、强化人才发展战略，提升科技创新能力

2024 年，公司坚持人才引进和优化两手抓，引入新鲜血液的同时，加大考核力度，对部分人员进行优化。同时注重既有人才的培养和选拔，大胆启用新人，让一批年轻人走上重要岗位，提升了人员士气和活力。新获得发明专利 6 项、实用新型专利 2 项、集成电路布图 64 项。截止 2024 年底，公司累计获得授权

的发明专利 37 项、实用新型专利 38 项、软件著作权 27 项、集成电路布图批准 241 项。

2025 年，公司将加大人才引进与培养力度，吸纳更多优秀人才，建立“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”的用人机制，优化人才结构。持续优化、细化绩效考核制度，制定科学合理的 OGSM 目标，优化公司、部门、个人三级绩效考核目标与内容，建立完善的薪酬体系和晋升通道，吸引和留住优秀人才，为年轻人提供更多的发展机会，提高员工的工作积极性和忠诚度，为公司长远发展提供人才保障和智力支持。

三、优化财务及库存管理，提高资金使用效率

2024 年，公司加强应收账款与存货控制管理。持续推行信用担保制度，要求赊销客户实控人进行担保，防范信用风险；持续监控逾期应收账款的回款情况，加大应收账款催收力度，采取对有信用风险的客户减少或者停止赊销等措施控制应收账款规模，应收账款增长率低于营收增长率。全年经营性净现金流为 3.1 亿元，与上年度相比增加约 2.8 亿元。

加强市场预测和备货计划管理，保持合理的存货水平。持续“去库存、抢市场”经营策略，加大公司出货量，有效消耗了库存，2024 年末，公司的存货约为 46,922 万元，比上年同期减少约 12%。

2025 年，公司继续加强应收账款和存货控制管理，同时完善内控制度，持续提高运行效率。增强市场研究，提高备货预测的准确性，通过应用领域拓展、客户拓展、份额拓展，继续增加公司产品出货量，加快存货周转，提高经营效率。推行精细化管理制度，加强各业务环节的监督和风险控制，确保每个职能部门都有识别和处理潜在风险的预案和能力，确保在突发事件发生时，能以最快的速度响应，将损失降到最低。

四、深化公司治理，保障规范运作

2024 年，结合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》的修订情况，公司对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理制度》和《信息披露管理制度》等规章制度完成修订，夯实了内部治理机

制。同时坚持加强对关键少数的学习与培训，将监管动态和典型案例汇编通报董监高，提升公司规范运作的能力和意识。

2025 年是本届董事会任期最后一年，公司一方面将狠抓制度的落实，让墙上的制度深入到意识，落实到行动，确保公司合规经营，稳定健康发展；另一方面要选好治理层和经营层，确保公司长远稳定发展。

五、提升信披质量，加强投资者交流

2024 年，公司披露公司定期报告、临时公告，做到了真实、准确、完整、规范、及时、充分，无重大遗漏、无重大差错。常年保持投资者热线电话畅通，积极回复上证 e 互动问题，参加各类投资者策略会，接待各类机构线上、线下调研，把公司的价值有效传递给投资者。

2025 年，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，通过公司官网、微信公众号等方式向广大投资者展示公司经营情况、研发情况、产品情况等；并继续做好内幕信息管理工作，切实维护好投资者获取信息的平等性。与此同时，公司将进一步优化投资者关系管理的工作机制和内容，丰富宣传途径和交流形式，探索构建多元化双向沟通渠道，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。

六、共享发展成果，注重投资者回报

2024 年，公司在 2023 年度经营出现亏损的情况，考虑到公司尚有历史滚存利润，修订了《股东分红规划》以满足加大对投资者的回报需求，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发现金红利总额为 99,898,750.00 元（含税）。上市 2 年以来，公司累计现金分红约 2.8 亿元，让全体股东切实分享到公司的发展成果。除此之外，基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，2023 年 8 月公布了回购股份方案，截止 2024 年 8 月回购期间结束，公司使用资金 3000 余万元，共计回购股份 1,506,639 股，计划用于员工激励。

2025 年，公司将用实实在在的发展讲好中微故事，做好市值管理，延续公司分红政策，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），预计派发现金红利总额为约 1 亿元（含税），持续用真金白银回报股东。未来，公司将继续统筹好

公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，采取季度、中期、年末等分红活动，提升广大投资者的回报收益。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

中微半导体（深圳）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日